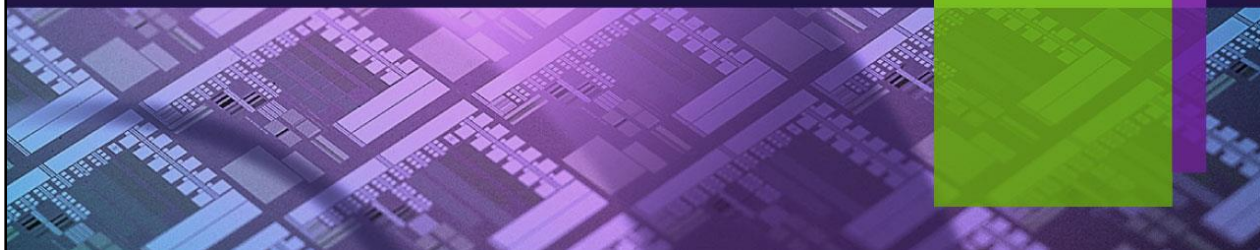


# 2026年3月期（2025年4月～2026年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

2026年4月30日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 デイビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



## 将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

## 2026年3月期 連結決算の概要

2026年4月30日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー  
川本 弘



改めまして、川本でございます。  
私から、2026年3月期、連結決算の概要をご説明いたします。

## 損益状況（四半期）

(億円)

	FY2025	FY2026				vs. FY2026 Q3	vs. FY2025 Q4
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
売上高	6,554	5,495	6,300	5,520	<b>7,118</b>	+28.9%	+8.6%
売上総利益	3,105	2,539	2,848	2,358	<b>3,331</b>	+41.3%	+7.3%
売上総利益率	47.4%	46.2%	45.2%	42.7%	<b>46.8%</b>	+4.1pts	-0.6pts
販管費	1,267	1,092	1,264	1,196	<b>1,275</b>	+6.6%	+0.6%
営業利益	1,837	1,446	1,584	1,161	<b>2,056</b>	+77.1%	+11.9%
営業利益率	28.0%	26.3%	25.1%	21.0%	<b>28.9%</b>	+7.9pts	+0.9pts
税金等調整前当期純利益	1,851	1,519	1,610	1,533	<b>2,818</b>	+83.8%	+52.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,429	1,178	1,238	1,185	<b>2,142</b>	+80.8%	+49.9%
研究開発費	727	621	726	662	<b>767</b>	+15.9%	+5.6%
設備投資額	346	528	912	303	<b>416</b>	+37.3%	+20.4%
減価償却費	183	171	191	211	<b>235</b>	+11.3%	+28.2%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

3. FY2025は2024年4月～2025年3月の会計年度を指しています。FY2026は2025年4月～2026年3月の会計年度を指しています。

まず、四半期の「損益状況」についてご説明いたします。

青枠の部分を中心にご覧ください。

第4四半期の売上高は、出荷タイミングにより一時的に落ち込んだ第3四半期と比較して28.9%増加し、7,118億円となりました。

これにより、売上総利益は、前四半期比41.3%増加の3,331億円。

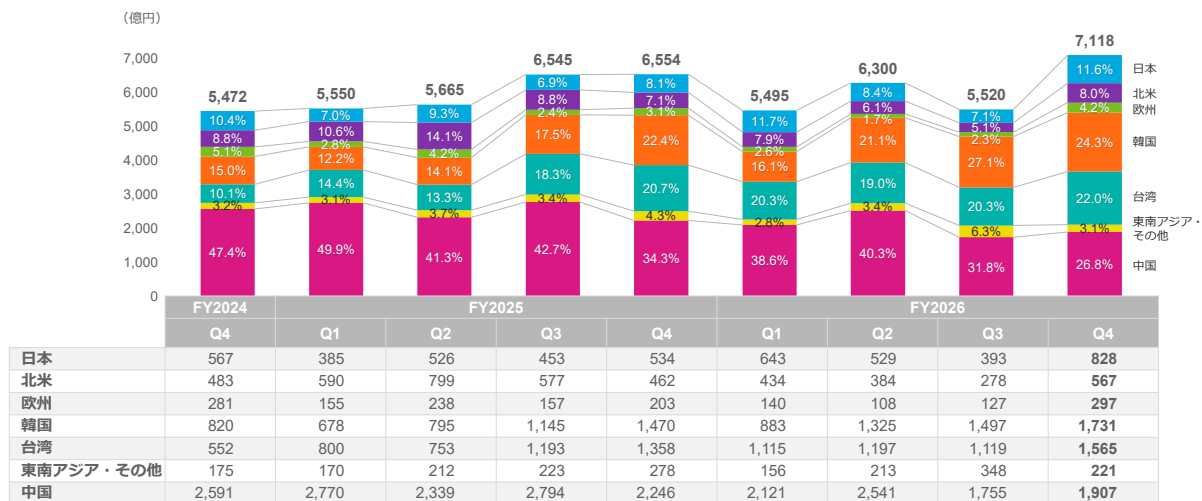
売上総利益率は、前四半期比4.1ポイント増加の46.8%となりました。

研究開発費を主とした販管費は増加しましたが、売上高に占める販管費比率は下がり、営業利益は前四半期比77.1%増加の2,056億円。

営業利益率は、前四半期比7.9ポイント増加の28.9%となりました。

また、親会社株主に帰属する当期純利益は、政策保有株式の売却による特別利益もあり、前四半期比80.8%増加の2,142億円となりました。

## 地域別売上高構成比（四半期）



こちらは、「地域別売上高」です。

第4四半期の構成比につきましては、台湾向け売上が大きく伸長し、前四半期比40%増加の、22.0%となりました。

一方で、先端向け投資の成長率がより高いことから、中国向けの売上高構成比は、前四半期比5.0ポイント減少の26.8%となりました。

なお、2026年3月期通期での中国向けの売上構成比は、34.1%でした。

## 損益状況（通期）

	FY2025	FY2026	対前期 増減	(億円) (ご参考) 2026年2月6日発表の FY2026予想
売上高	24,315	24,435	+0.5%	24,100
売上総利益	11,462	11,078	-3.4%	10,920
売上総利益率	47.1%	45.3%	-1.8pts	45.3%
販管費	4,489	4,829	+7.6%	4,990
営業利益	6,973	6,249	-10.4%	5,930
営業利益率	28.7%	25.6%	-3.1pts	24.6%
税金等調整前当期純利益	7,061	7,481	+6.0%	7,140
親会社株主に帰属する当期純利益	5,441	5,744	+5.6%	5,500
1株当たり当期純利益（円）	1,182.40	1,254.57	+6.1%	1,200.05
研究開発費	2,500	2,778	+11.1%	2,900
設備投資額	1,621	2,160	+33.2%	2,400
減価償却費	621	809	+30.3%	860

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

続きまして、通期の「損益状況」です。

先端顧客における設備投資が引き続き活発に行われたことに加えて、顧客の工場稼働率が上がりフィールドソリューションの売上も好調だったことから、売上高は、2兆4,435億円、前期比0.5%の増加となり、前期に続き過去最高を更新いたしました。

売上総利益は、1兆1,078億円となり、当期も1兆円を超えました。

売上総利益率は45.3%と前期比1.8ポイント減少しておりますが、これは部材価格の高騰、プロダクトミックスの変化に加え、今後の成長に備えて海外のサービスエンジニアを増員したことによるものです。

営業利益は、6,249億円となりました。

営業利益率に関しましては、前期比3.1ポイント減少の25.6%となっておりますが、これは主に将来の成長と競争力強化に向けた研究開発投資を積極的に実施したことによるものです。

研究開発費は前期比11.1%増加の2,778億円でございます。

また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比5.6%増加し、過去最高の5,744億円となりました。

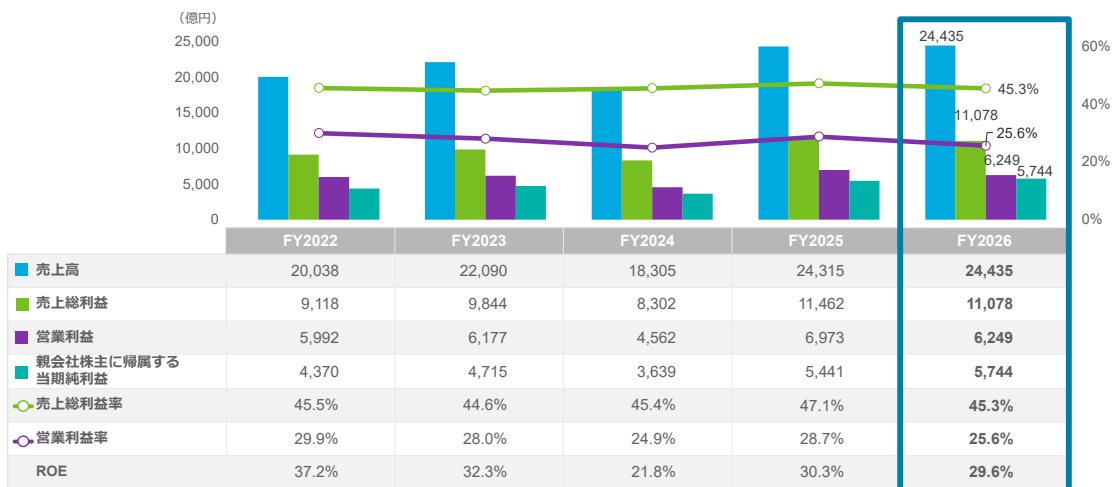
なお、政策保有株式を売却し、1,154億円の特別利益を計上しております。

設備投資額は2,160億円。

宮城と熊本の開発棟、岩手の生産・物流センターの竣工、評価用機械装置の取得などによるものです。

減価償却費は、前期比30.3%増加の809億円となりました。

## 損益状況の推移（FY2022～FY2026）

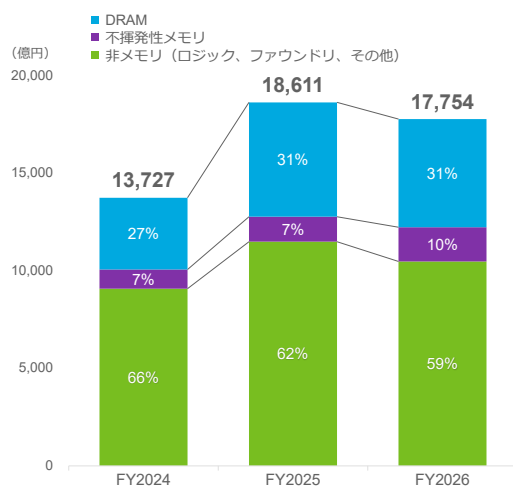


売上高は過去最高の業績を達成

こちらのグラフでは、先ほどご説明させていただいた業績を時系列で示しておりますので、ご確認ください。

なお、ROE は前期に続き30%に近い水準となりました。

## SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比



1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置  
 2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれておりません。

Investor Relations / April 30, 2026

TEL

8

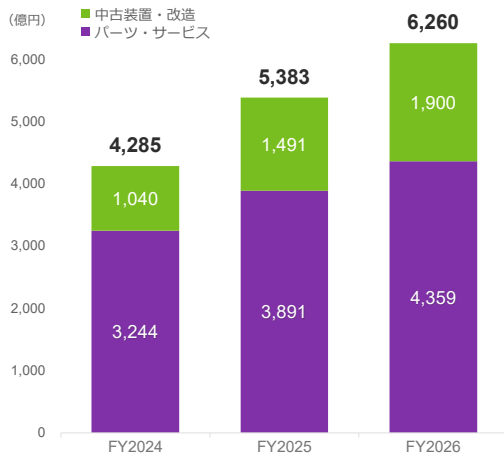
こちらは、SPE新規装置の売上をアプリケーション別に示したものです。2026年3月期は、上からDRAM 31%、不揮発性メモリ10%、非メモリ 59%となりました。

DRAMにおいてはHBM向けなど、先端投資が引き続き堅調ながら顧客ごとに濃淡があり、売上高、構成比とも、概ね同水準でした。

不揮発性メモリにおいては、顧客の工場稼働率が大幅に改善し、投資は回復基調に転じております。売上高、構成比とともに増加傾向となりました。

非メモリは、成熟向け投資が一服した一方で、最先端設備投資が非常に活発に行われたことで、前期に引き続き1兆円を上回る規模となりました。

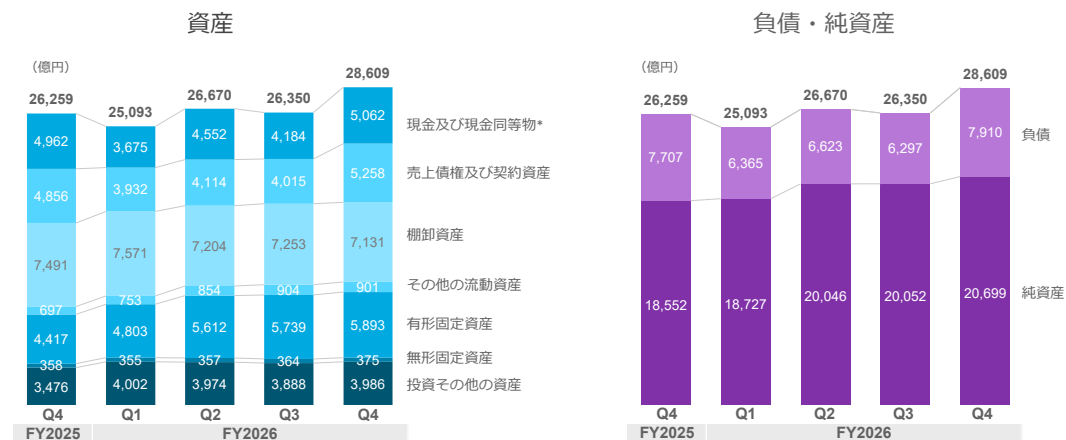
## フィールドソリューション売上



- FY2026の売上は、前期比16.3%増の6,260億円
- 顧客の工場稼働率が一段と上昇し、パーツ・サービス、改造ともに好調

続きまして、フィールドソリューション売上になります。  
2026年3月期の売上高は、前期比 16.3%増加の 6,260億円となりました。  
顧客の工場稼働率が一段と上昇したことに伴い、パーツ・サービスビジネスが拡大したほか、生産性向上のための改造案件も多く、売上高は好調に推移いたしました。

## 貸借対照表（四半期）



\*現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

続きまして、「貸借対照表」をご説明いたします。

資産合計は、2兆8,609億円となりました。

現金同等物は、5,062億円。

前四半期から877億円増加いたしました。

売上債権及び契約資産は、前四半期比1,243億円増加の5,258億円。

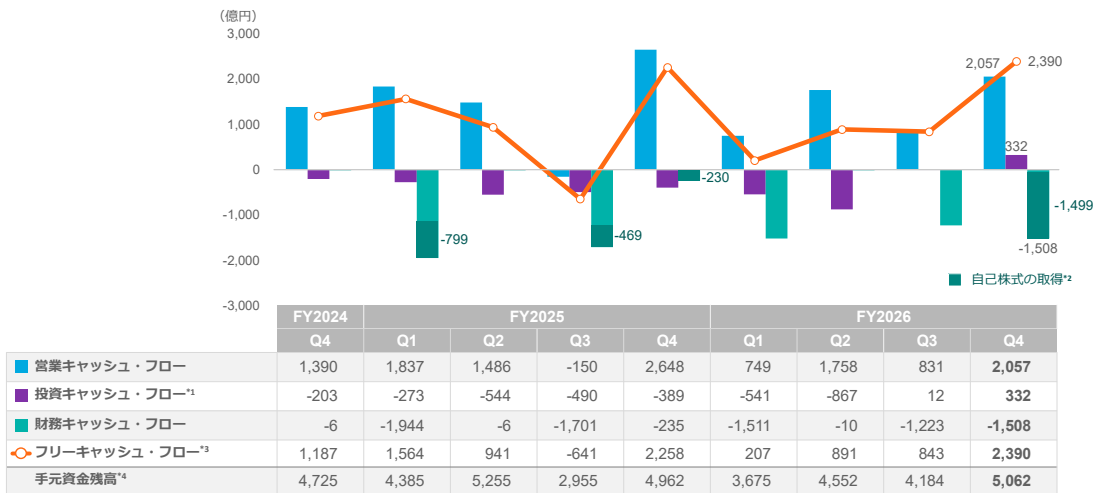
棚卸資産は、前四半期比122億円減少の7,131億円。

有形固定資産は、前四半期から153億円増加し、5,893億円となりました。

続いて、右側の負債・純資産でございますが、負債は、前四半期から1,612億円増加の7,910億円となりました。

純資産は、前四半期比647億円増加の2兆699億円となりました。

## キャッシュ・フロー（四半期）



\*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

\*2 自己株式の取得は、単元未満株式の買取りに要した金額を除いた金額です。

\*3 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

\*4 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

Investor Relations / April 30, 2026

TEL

11

続きまして、「キャッシュ・フロー」をご説明いたします。

この四半期における営業キャッシュフロー獲得は、2,057億円ございました。

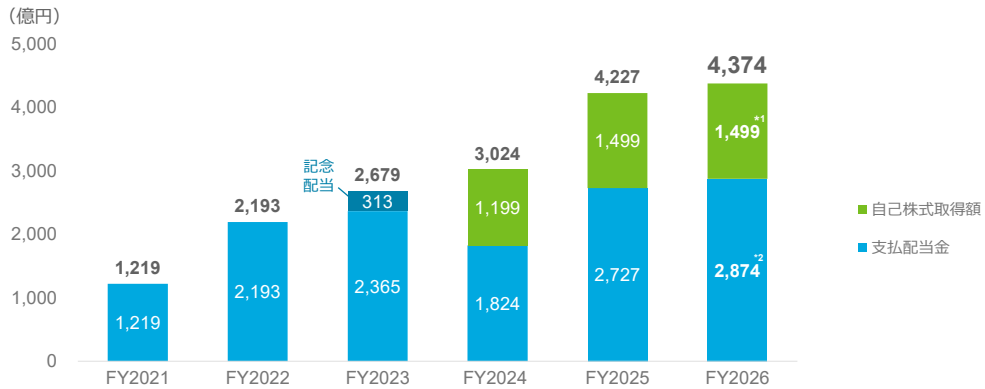
投資キャッシュフローは、有形固定資産の取得や投資有価証券の売却等の結果、332億円の収入となりました。

財務キャッシュフローの支出は、自己株式取得をおこなったことから、1,508億円。

また、フリーキャッシュフローは、2,390億円の収入となりました。

通期ベースでも4,332億円の収入となり、どちらも過去最高となりました。

## 総還元額



<sup>\*1</sup> [https://www.tel.co.jp/news/ir/2026/bk8a0u0000000011-atu/20260327\\_002.pdf](https://www.tel.co.jp/news/ir/2026/bk8a0u0000000011-atu/20260327_002.pdf)

<sup>\*2</sup> 2026年3月期の期末配当額については取締役会決議前の予定額です。

### 自己株式取得と合わせ、過去最高の総還元額

最後に、「総還元額の推移」になります。

まず、2月に発表した自己株式取得は終了し、取得額の総額は1,499億円となりました。

また、3月27日の取締役会にて、4月30日に360万株の自己株式を消却することを決議しております。

今期の総還元額は、4,374億円と、前期を上回り、過去最高の総還元額になりました。

私からのご説明は以上です。ありがとうございました。

## 事業環境および業績予想

2026年4月30日

代表取締役社長・CEO  
河合 利樹



皆さま、改めまして、河合でございます。  
わたくしの方から、「事業環境 および 業績予想」について、ご説明致します。

## 2026年3月期 事業ハイライト

### 過去最高の 売上高・当期純利益

- 売上高
  - Q4：7,118億円
  - 通期：2兆4,435億円
- 当期純利益
  - Q4：2,142億円
  - 通期：5,744億円

### 次なる成長へ 盤石なインフラを準備

- 竣工
  - 宮城・熊本の新開発棟
  - 岩手の生産・物流センター
- 着工
  - 宮城の生産新棟：スマートプロダクション構想を採用

### 成長が期待される 先端領域でのPOR獲得

- メモリ
  - キャパシタ・HBM配線層など主要工程のPORを専有
- アドバンストパッケージング
  - 複数の製品がPORを獲得

まず、「2026年3月期の事業ハイライト」についてご説明します。

FY2026は、前年から続くAIサーバー向けの先端ロジックやDRAM/HBM投資に加え、長らく手控えられていた3DNANDの投資も回復の兆しを見せ、顧客稼働率の上昇にともなうフィールドソリューション売上の増加もあり、通期の売上高は2兆4,435億円と、過去最高を記録しました。

当期純利益につきましては、資本効率の向上を図り、政策保有株式を売却したことによる特別利益の計上もあり、通期で5,744億円と、過去最高となりました。

また、次なる成長を見据えて建設を進めてきました、宮城、熊本の開発棟、岩手の生産・物流センターが竣工いたしました。

そして、未来の製造を支えるスマートプロダクション構想を採り入れた宮城 生産新棟を着工いたしました。

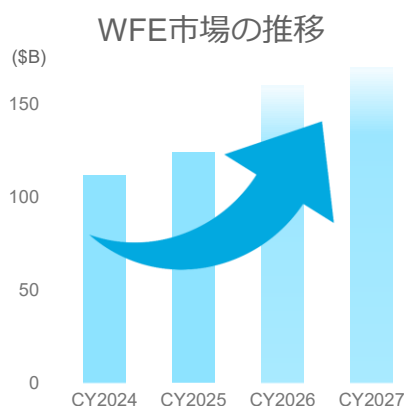
急峻に拡大するWFE市場にも迅速に対応すべく、盤石なキャパシティを確保しています。

将来の売上成長に寄与する先端領域におけるPORの獲得も、順調に進捗しました。

当社が得意とするメモリにおいては、キャパシタ工程・HBM配線工程など、エッチングの主要な工程で、高いシェアを獲得しております。

また、成長著しいアドバンストパッケージングにおいても、当社の持つ幅広い製品ラインナップで、前工程から、3次元実装・テストまで、複数の製品でPORを獲得しております。

## 事業環境 (2026年4月時点でのWFE市場の見方)



### CY2026~2027 WFE市場の見通し

- \$150B~170B/年のレンジ  
(CY2025比 +20%以上) で想定
- 先端デバイス向けは +30%以上
- 地政学的リスクは要注視

次に、「事業環境」について、ご説明します。

CY2026から2027にかけての2年間のWFE市場の見通しは、CY2025年比で、少なくとも20%以上の成長を見込んでおり、年150から170Bドルのレンジになると想定しております。

一方、当社が注力している先端デバイス向けの投資に関しては、足もとの強い引き合いから、前年比30%以上の成長を見込んでおります。

なお、昨今の地政学的リスクに関しては、現在のところ、顧客の投資動向に変化は見られません。

しかし、ホルムズ海峡の封鎖が長期化する場合には、サプライチェーンの混乱によって部材不足が危惧されるため、注視が必要です。

## 2027年3月期 売上成長ドライバー

### 塗布・現像

- マーケットシェア 90%以上
- DRAMと先端ロジックにおける大幅な投資増の機会を捉える
- FY2027売上 YoY +50%以上

### エッチング

- マーケットシェア 50%以上（絶縁膜エッチング）
- HARC工程、配線工程、GAA工程
- FY2027売上 YoY +25%以上

### アドバンスト パッケージング

- 先端ロジック向けプローバ専有、高シェアHBM向けボンディング装置
- 塗布・現像、エッチング、成膜装置などのPOR拡大
- FY2026 売上実績 約2,000億円、FY2027 売上 YoY +60%以上

このような事業環境における、当社の「2027年3月期の売上成長ドライバー」についてご説明します。

今年の市場成長を牽引する 先端デバイス向け投資の中でも、大きな売上貢献が期待できるのが、塗布・現像装置、および、エッチング装置です

特に、塗布・現像装置は、世界シェア90%以上を誇り、DRAMにおけるEUV技術の採用や、ロジックにおけるEUVマルチパターニングはもとより、ほぼ全ての顧客の増産投資・微細化投資の引き合いを受けております。

これにより、FY2027の塗布・現像装置の売上は、前期比 50%以上の成長となる見込みです。

エッチング装置については、当社は絶縁膜エッチングを得意としており、現在、その世界シェアは 50%以上です。

DRAMキャパシタ工程では大手顧客のPORを専有、HBM向けに増加している配線工程でも、大変高いシェアを保持しています。

ロジック 2ナノメートルから採用された、GAA、ゲートオールアラウンド構造では、ゲートエッチングや等方性エッチングの事業機会が拡大しております。

これらを背景に、FY2027のエッチング装置の売上は、前期比30%の成長に迫る勢いです。

また、幅広い製品ラインナップを取り揃えている当社は、アドバンストパッケージングについても、大変多くの成長機会に恵まれています。

プローバについては、圧倒的シェアを誇る先端ロジック向けで、着実に売上を伸ばしており、今期は 1,000億円を超える見込みです。

HBM向け ボンダー・デボンダーや、ロジック 3次元実装向け 永久接合ボンダー、加えて、3DNAND向けの貼り合わせ装置も増加しています。

FY2027のアドバンストパッケージング向けの売上は、アドバンストパッケージングに使用する塗布・現像、エッチング、成膜装置なども含めて、前期比 60%以上の成長となる想定です。

## 2027年3月期 業績予想

(億円)

	FY2026 (実績)			FY2027 (予想)
	H1	H2	通期	H1
売上高	11,796	12,638	24,435	15,700
売上総利益	5,388	5,690	11,078	7,150
売上総利益率	45.7%	45.0%	45.3%	45.5%
販管費	2,357	2,472	4,829	2,840
研究開発費	1,348	1,430	2,778	1,600
研究開発費以外の販管費	1,009	1,041	2,050	1,240
営業利益	3,031	3,217	6,249	4,310
営業利益率	25.7%	25.5%	25.6%	27.5%
税金等調整前当期純利益	3,129	4,351	7,481	4,370
親会社株主に帰属する当期純利益	2,416	3,328	5,744	3,280
1株当たり当期純利益 (円)	527.31		1,254.57	721.12

- FY2027 上期：  
AIサーバー向け需要が牽引し、過去最高の売上高、売上総利益、営業利益を見込む
- 2026年後半にかけて、DRAM・先端ロジックを中心に更に出荷が増加
- ホルムズ海峡の封鎖の影響は要注視

次に、「業績予想」についてです。

はじめに、業績予想の開示期間の変更について、触れさせていただきます。

半導体製造装置市場は中長期的に成長が見込まれる一方、顧客の設備投資は、過去に比べ拡大しており、需給バランスや各社の戦略、地政学的要因などにより、投資計画が期中に変化することがあります。

特に、一部の顧客の投資規模が極めて大きくなっており、その動向が当社グループの業績に与える影響は、相対的に大きくなっています。

こうした事情を踏まえ、期末決算時に開示しておりました翌期の通期業績予想については、今期より、中間期分のみの開示とし、より適時、かつ、実態に即した情報提供に努めてまいります。

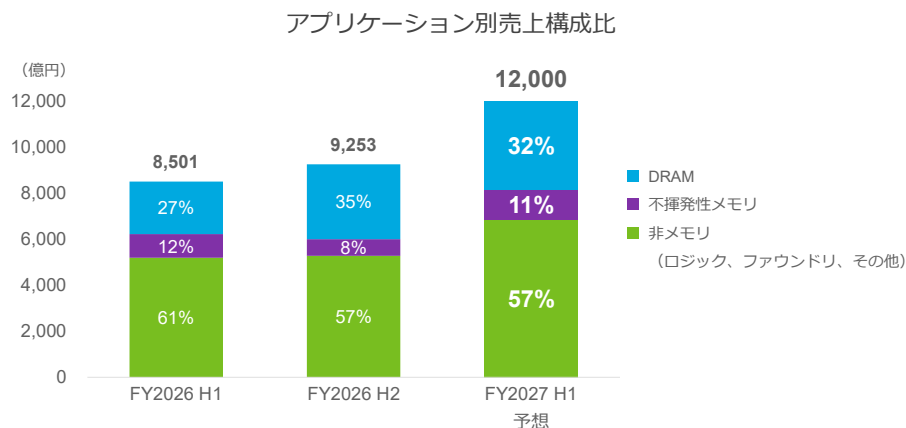
さて、FY2027 上期の業績予想につきましては、旺盛なAIサーバー向け需要を背景に、売上高 1兆 5,700億円、売上総利益 7,150億円、営業利益 4,310億円と、いずれも、半期で過去最高の業績を見込んでおります。

また、FY2027 下期につきましては、DRAM・先端ロジックを中心に、更に出荷が増加し、上期を上回る力強い成長を想定しています。

なお、前述の通り、ホルムズ海峡の封鎖による影響は注視が必要ですが、現時点においては、お客様の投資計画に変化はございません。

また、当社が今上期に売上計上を予定している装置に必要な部材については、確保できております。

## 2027年3月期 SPE新規装置売上予想



\* グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

**SPE新規売上が伸長し、前年同期比+41%**

こちらは、「2027年3月期のSPE新規装置の売上予想」です。  
今上期の新規装置の売上は、前年同期比41%増の1兆2,000億円となる見込みです。  
アプリケーションごとの内訳は、ご覧の通りです。  
AIサーバー需要にけん引され、先端デバイス向け装置売上が伸長する計画です。

## 2027年3月期 研究開発費・設備投資計画

宮城 第3開発棟  
エッチング装置



宮城県黒川郡  
2025年4月 竣工

熊本 プロセス開発棟  
コータ/デベロッパ、洗浄装置



熊本県合志市  
2025年10月 竣工

東北生産・物流センター  
成膜装置

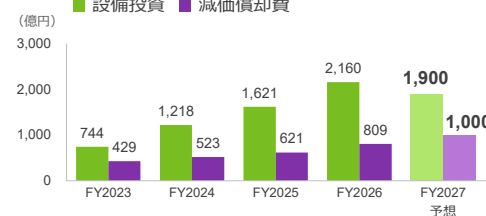
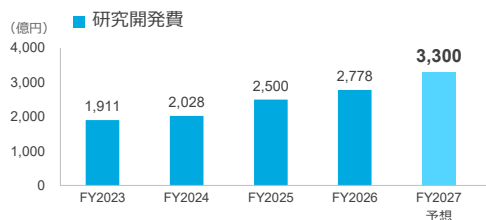


岩手県奥州市  
2025年11月 竣工

宮城生産革新センター  
エッチング装置



宮城県黒川郡  
2027年夏 竣工予定



研究開発投資を主軸に競争力の強化を継続  
強固なインフラを活用し、今後の収益機会を着実に捉える

次に、「研究開発費と設備投資の計画」についてです。

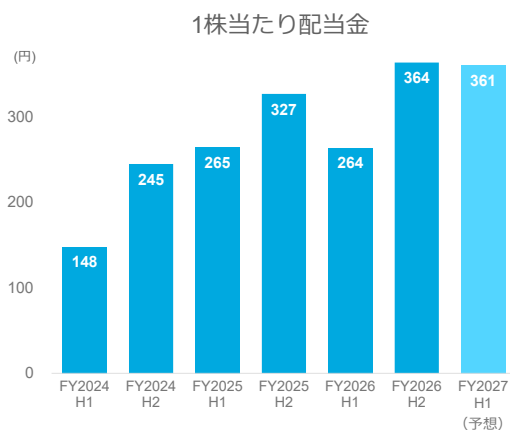
FY2027の研究開発費は通期 3,300億円を計画しており、技術競争力の源泉となる研究開発を積極的に推進し、半導体の技術革新を支えてまいります。

設備投資は、通期 1,900億円を予定しております。

前期に完成した開発棟における機械装置の取得や、来年夏にスマートファブとして竣工を予定しております宮城の生産新棟が主な内容です。

ここに記載しているような強固なインフラを活用し、今後の収益機会を着実に捉え、企業価値の最大化に取り組んでまいります。

## 配当予想



### 当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

FY2027 H1（中間配当）の1株当たり配当金は361円を見込む

最後に、「配当予想」についてです。

業績予想の開示期間の変更に伴い、配当予想につきましても、中間配当の予想のみを開示しております。

今期 FY2027の中間配当は、1株当たり361円を予定しており、前半期同様、高い水準になる見込みです。

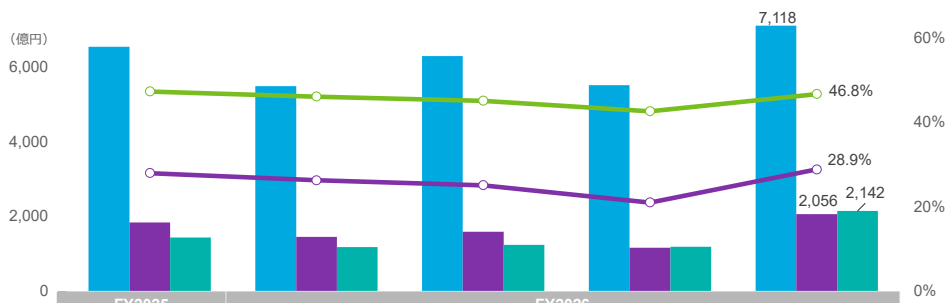
私からのご説明は以上です。

ご清聴ありがとうございました。



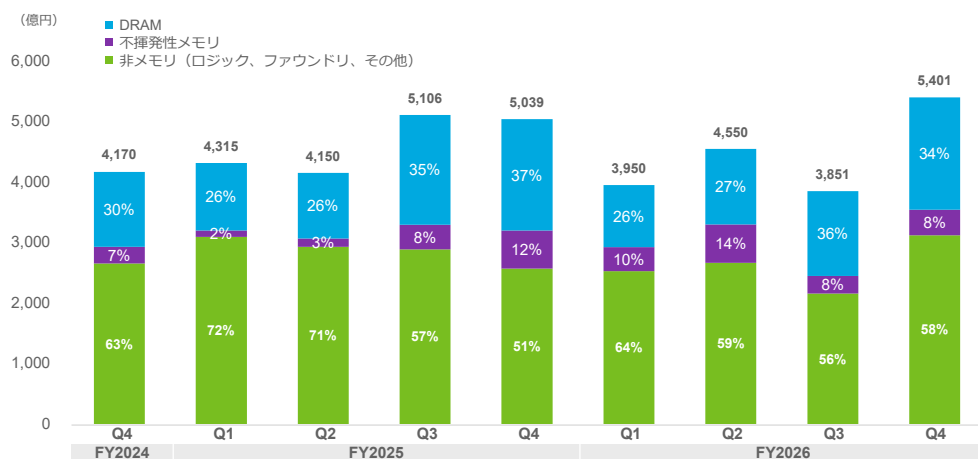
# 補足資料

# 損益状況（四半期）



	FY2025		FY2026		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
■ 売上高	6,554	5,495	6,300	5,520	<b>7,118</b>
■ 営業利益	1,837	1,446	1,584	1,161	<b>2,056</b>
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	1,429	1,178	1,238	1,185	<b>2,142</b>
○ 売上総利益率	47.4%	46.2%	45.2%	42.7%	<b>46.8%</b>
○ 営業利益率	28.0%	26.3%	25.1%	21.0%	<b>28.9%</b>

# SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）

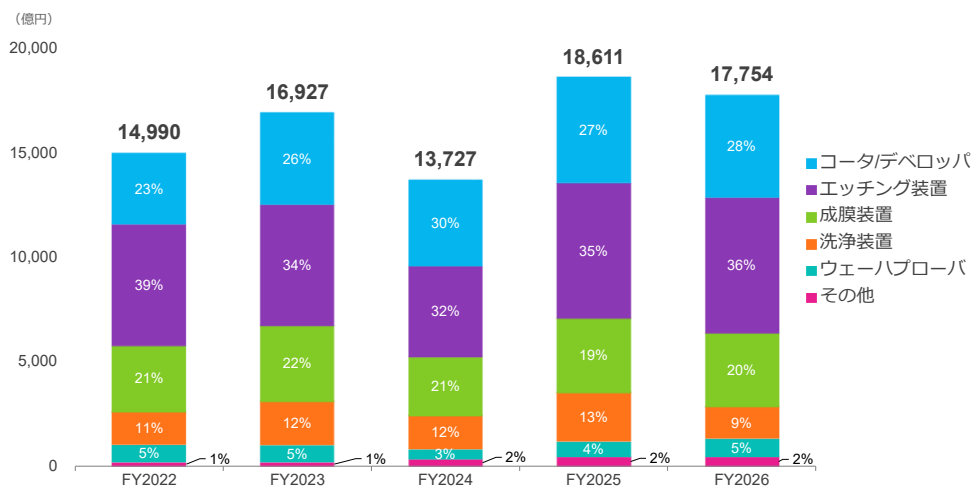


1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置  
 2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

# フィールドソリューション売上高 (四半期)

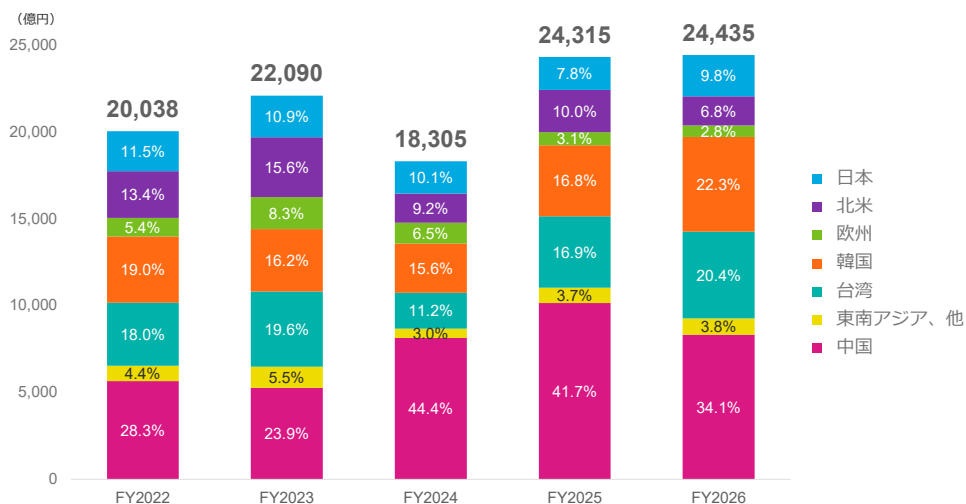


# SPE新規装置 製品別売上構成比



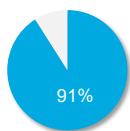
1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置  
 2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれておりません。

# 地域別売上高構成比

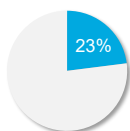


1. SPE (Semiconductor Production Equipment) : 半導体製造装置  
 2. グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれておりません。

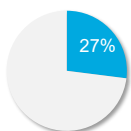
# 主要プロダクト 世界市場シェア (CY2025)



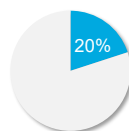
コートデベロッパ



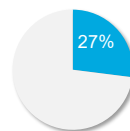
ドライエッチング装置



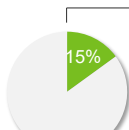
成膜装置



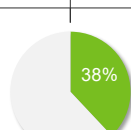
洗浄装置



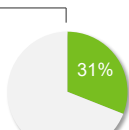
ウェーハボンダー



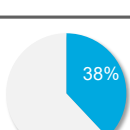
ALD



CVD



酸化/拡散



ウェーハプローバ

出所  
Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2025, Bob Johnson and Menglin Cao, 2 April 2026. Revenue from Shipments basis.  
チャートはカテゴリーリサーチに基づき、東京エレクトロンが作成。ここに記載のある数値は、東京エレクトロンにより算出されたものです。  
コートデベロッパ: Photolith Processing (Track), ドライエッチング装置: Dry Etch, 成膜装置: Tube CVD + Atomic Layer Deposition Tools + Oxidation/Diffusion Furnaces + Nontube LPCVD, ALD: Atomic Layer Deposition Tools, CVD: Tube CVD + Nontube LPCVD, 酸化/拡散: Oxidation/Diffusion Furnaces, 洗浄装置: Single Wafer Processors + Wet Stations + Batch Spray Processors + Scrubbers + Other Clean Equipment, ウェーハボンダー: Wafer Bonder  
GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の承認およびその数値に基づく信頼性および正確性を保証するものではありません。Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に特許された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにプロジューサーに勧誘するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの視察を求めているものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。  
本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerプラットフォーム・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

出所  
半導体製造装置 (ウェーハプローバ) : Auto Probers;  
Technights Inc., April 2026  
図はTechnights Inc.に基づき、東京エレクトロンが作成。

## 本資料の取扱い上の注意

当社の書面による承諾なしに複写、または  
第三者への開示はできません。

東京エレクトロン

**TEL** および“TEL”は、東京エレクトロン株式会社の商標です。